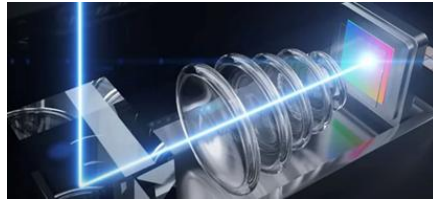


低反発カバーレイ 『C90シリーズ』

使用例

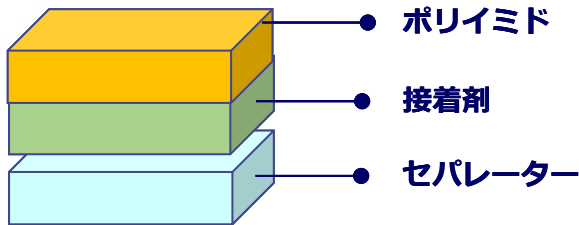
- ・スマートフォン
- ・タブレット
- ・デジタルカメラ



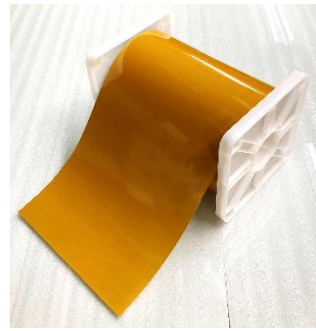
特徴

- ・低反発性且つ、形状保持性により、折り曲げ組み込みが可能です。
- ・ファイン回路(L/S=20/20)向けの高絶縁カバーレイです。

構成



製品外観



特性

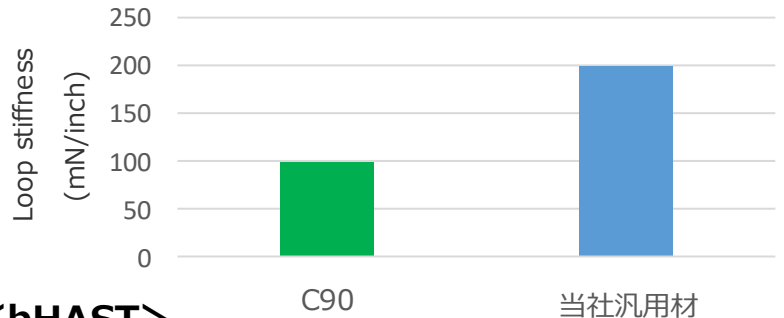
<特性表>

項目	単位	C90
引きはがし強さ (90°Cu引き)	N/cm	8
はんだ耐熱性	℃	300
難燃性	-	V-0 相当
接着剤 Tg	℃	54
接着剤 弾性率	GPa	0.4

プレス条件：

160℃×3MPa×保持 45min.

<反発力試験>



<bHAST>

